



2024 年儲備菁英獎助學金申請表

基本資料	姓 名		生 日	年 月 日		照 片 黏貼處
	身分證號		血 型			
	性 別	☐ 男 ☐ 女	身 高		體 重	
兵役	☐ 未役,預計____年____月入伍		e-mail			
	☐ 役畢____年____月至____年____月		電 話	住家：		
	☐ 免役，原因：_____			行動：		
地址	戶 籍					
	通 訊					
家長姓名				與申請人關係		
服務單位 (單位與職稱)				聯絡電話		
學歷	學位	學校名稱	系 所		畢業年月(預計)	
	博士				____年____月入校 目前就讀____年級 預計____年____月畢業	
	碩士				____年____月入校 目前就讀____年級 預計____年____月畢業	
	大學				____年____月	
	高中				____年____月	
在校最喜歡之科目 (請填寫原因)		1. 原因： 2. 原因： 3. 原因： 示意例1：有無參與產學合作委託研究_____ 示意例2：有無參加過電路板製程工程師認證考試或關聯演講/課程_____ 示意例3：有無關聯競賽/投稿/專題研究_____				

個人專長					
語言能力 (重要參考資料)	語言	精通	普通	略通	不會
	英語				
	日語				
	其他				
電腦技能					
學校系所所長 初審意見				(請加蓋系所印章)	
	系所所長簽章:				
附繳證件 請於□內打勾	☐ 上一學期成績單正本。 ☐ 學生證及身分證正反面影本各乙份。 ☐ 自傳、研究計劃、專題報告及不低於 500 字之生涯規劃書。 ☐ 其他，如參與競賽、各類技能或其他外語檢定相關證明文件。				
收理期限及 申請方式	本申請表於校方初審後，須請連同繳附證件於 2024 年 4 月 14 日以前提交 【正本】掛號郵寄方式（以郵戳為憑）寄予《獎學金專案小組》，逾期恕不受理。 地址：33754 桃園市大園區三石里三和路 28 巷 6 號 【電子檔】可編輯 word 檔及掃描 pdf 檔，mail 予 sylvia.tf.yang@zdtco.com 電話：03-3835678 #33250 楊庭芳				

*聲明：申請人_____在此申明，本人未受領其他有服務義務約定之獎助學金，並已詳閱本獎學金之相關辦法，申請書內所填寫內容均屬確實，如有虛偽情事，本人將負一切責任。

申請人：_____ (簽章)